

MIRS 不具合報告書

1班 報告者 勝間田早矢 発見日 令和5年1月28日 完了日 令和5年2月6日

不具合件名	要因分析
RaspberryPi 動作不良	配線基板を新規作成した。
不具合の概要	①製作に使用した基板は、既存品から素子を取り除くことにより再利用した。これにより、基板はんだ面自体に接触不良などの問題が生じてしまった可能性が考えられる。
RaspberryPi の動作が停止した。一度 SD カードを別のものに変更し動作させることができたが、また動作停止が起きた。 ソフトとメカでの原因特定に至らなかったため、エレキ面に原因がある可能性が高いと考えられる。	②配線時に使用したコードを途中で移動したり変更したことによって、コードが隣り合うはんだ間の距離が近くなってしまったことも不具合要因として考えられる。
考えられる要因	①、②のように、はんだの接合・取り除きを繰り返したことにより、基板のランドがはがれてしまったり、フラックスが蒸発したりした結果、素子とはんだの接合が不十分となった可能性が考えられる。
・配線の接触不良 ・基板不良	
	不具合箇所の別（エレキ）および詳細
	ここをクリックしてテキストを入力してください。
	対策
	・はんだ接合部にフラックスを使用することにより対策ができたと思われる。支給物品に追加希望。 ・接合部間の距離を 1,2mm 程度とるか、絶縁体を間に挿入することにより対策ができたと思われる。